

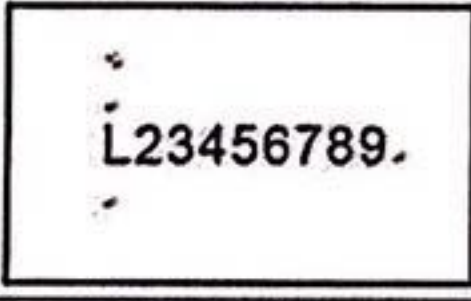

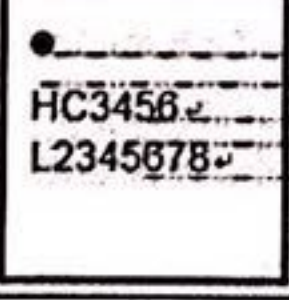



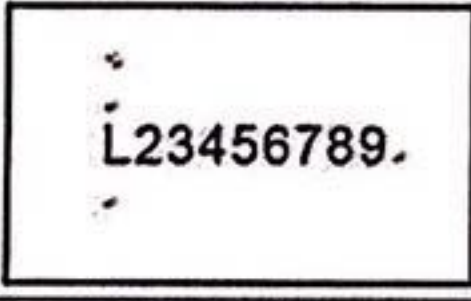

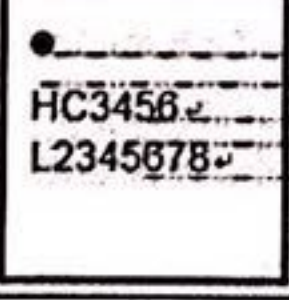



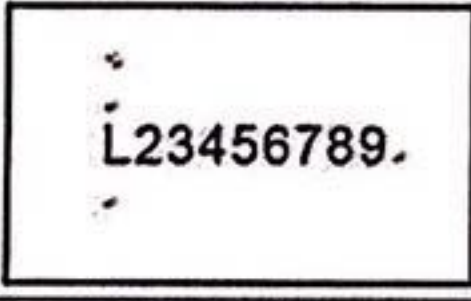

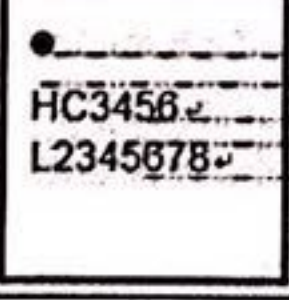




PRODUCT CHANGE NOTICE

PCN 编号	PCN20190308-2	发行人:	发行日期:
		张姚	2019-3-8
客户名称		联系人:	

受影响产品	商业名称	规格型号	备注														
	NA	NA	所有 IC 产品														
变更原因描述	当前华大 MCU 事业部 QFN 3*3 等小封装尺寸的芯片表面印章信息仅打印商业名称前 6~8 位，根据商业名称的命名规则，商业名称打印出前 10 位，才可以通过芯片印章有效的识别芯片的类型，以及明确区分同项目同封装不同商业编号的芯片，根据以上需求优化各封装类型的印章规范，将芯片的商业编号的至少前 10 位打印在芯片表面。																
变更方法描述	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 20%;">封装形式</th> <th colspan="2">示意图</th> </tr> <tr> <th style="width: 40%;">当前印章</th> <th style="width: 40%;">改版后印章</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TSSOP 16 4.06 x 4.4</td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>TSSOP20 空白片</td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td>QFN 3 x 3</td> <td>  </td> <td>  </td> </tr> </tbody> </table>			封装形式	示意图		当前印章	改版后印章	TSSOP 16 4.06 x 4.4			TSSOP20 空白片			QFN 3 x 3		
封装形式	示意图																
	当前印章	改版后印章															
TSSOP 16 4.06 x 4.4																	
TSSOP20 空白片																	
QFN 3 x 3																	

封装形式	示意图	
	当前印章	改版后印章
QFN 4 x 4		
QFN 5 x 5		
QFN 6 x 6		
封装形式	示意图	
	当前印章	改版后印章
QFN 7 x 7		
变更生效日期或产品 Date Code 说明: 无		
华大半导体 MCU 事业部工程部经理签署: 		
日期: 2019.3.12		
客户	确认意见	MCU事业部
签署:	日期:	